

【電子部品・電子機器のサービス一覧表】

段階	商品設計	部品調達	基板実装	製品組立	品質検査	修理・保守
開発・施策 / 量産試作・量産						
サービス内容	アナログデザイン 電源 大電流 オーディオ 映像商品設計		0201チップ実装			
			0603ディップ 実装			
			最小0.1mmギャッ プ実装			
	デジタルデザイン FPGA設計 マイコン設計 基板設計 EMC設計対策		三次元実装			
	COB実装					
	ディスクリート 実装					
開発技術			機能性フィルムへ の実装技術 (※1)			
			201コンデンサ内蔵 半導体 サブプレート (※2)			

※1 機能性フィルムへの実装技術を用いて、製品設計やデザイン等の制限を緩和し、製品の可能性を広げます。

※2 0201コンデンサ内蔵半導体サブプレート（共同開発）により、G以上の高速大容量伝送のEMCソリューションを提供します。